

<<电子整机装配工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子整机装配工艺>>

13位ISBN编号：9787121046612

10位ISBN编号：712104661X

出版时间：2007-7

出版时间：电子工业出版社

作者：费小平 编

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子整机装配工艺>>

内容概要

本书是职业院校电子信息类专业系列教材之一。

本教材的编写遵循“理论够用，实践为重”的原则。

全书共分10章，前9章为理论知识，内容包括电子元器件、常用材料和工具、表面安装技术、印制电路板的设计与制作、焊接工艺、整机装配工艺、整机调试与检验、电子产品的技术文件及产品认证和体系认证，每章后有小结和习题；第10章为各知识点的实训项目。

本书可作为职业院校电子信息类专业教材，也可作为电子工程技术人员的参考用书及电子企业对员工的技术培训教材。

<<电子整机装配工艺>>

书籍目录

第1章 电子元器件	1.1 常用电子元器件简介	1.1.1 电阻器	1.1.2 电容器	1.1.3 电感器
	1.1.4 半导体分立器件	1.1.5 集成电路	1.1.6 光电器件	1.1.7 电声器件
	1.1.8 电磁元件	1.1.9 机电元件	1.2 电子元器件的检验和筛选	1.2.1 外观质量检验
	1.2.2 电气性能使用筛选	1.3 本章小结	1.4 思考与习题	第2章 常用材料和工具
	2.1 常用导线与绝缘材料	2.1.1 导线	2.1.2 绝缘材料	2.2 覆铜板
	2.2.1 覆铜板的组成与制造	2.2.2 覆铜板的技术指标和性能特点	2.3 其他常用材料	2.3.1 磁性材料
	2.3.2 黏合剂	2.3.3 静电防护材料和设备	2.3.4 电子安装小配件	2.4 常用装接工具
	2.4.1 装配工具	2.4.2 焊接工具	2.5 本章小结	2.6 思考与习题
第3章 表面安装技术	3.1 概述	3.1.1 SMT的发展过程	3.1.2 SMT技术的特点	3.2 SMT工艺的生产材料
	3.2.1 膏状焊料	3.2.2 无铅焊料	3.2.3 助焊剂	3.2.4 黏合剂
	3.3 表面安装元器件	3.3.1 表面安装元器件的种类和规格	3.3.2 表面安装元器件的极性识别	3.3.3 使用表面安装元器件的注意事项
	3.4 SMT电路板组装方案和装配焊接设备	3.4.1 SMT电路板组装方案	3.4.2 SMT电路板装配焊接设备	3.5 本章小结
	3.6 思考与习题	第4章 印制电路板的设计与制作	4.1 概述	4.1.1 印制电路板的作用
	4.1.2 印制电路板的种类	4.2 印制电路板的设计	4.2.1 印制电路板的设计目标	4.2.2 印制电路板的设计步骤
	4.2.3 印制电路板的设计要求	4.2.4 SMT印制电路板的设计	4.2.5 印制电路板CAD/EDA软件简介	4.3 印制电路板的制造工艺
	4.3.1 印制电路板的制造工艺流程	4.3.2 手工自制印制电路板的方法	4.4 本章小结	4.5 思考与习题
第5章 焊接工艺	5.1 焊接材料	5.1.1 焊料	5.1.2 助焊剂	5.1.3 阻焊剂
	5.2 焊接的基本知识	5.2.1 概述	5.2.2 锡焊机理	5.2.3 锡焊焊点的形成过程和条件
	5.3 手工焊接	5.3.1 手工焊接方法	5.3.2 手工焊接技巧	5.3.3 拆焊
	5.3.4 焊点质量及检查	5.3.5 SMT元器件的手工焊接	5.4 电子工业自动化焊接技术	5.4.1 浸焊
	5.4.2 波峰焊	5.4.3 再流焊	5.5 本章小结	5.6 思考与习题
第6章 整机装配工艺	第7章 整机调试与检验	第8章 电子产品的技术文件	第9章 产品认证和体系认证	第10章 实训项目参考文献

<<电子整机装配工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>